

FUJITSUFUJITSU PLM解决方案

良品解析事例（Cu线IC开封）



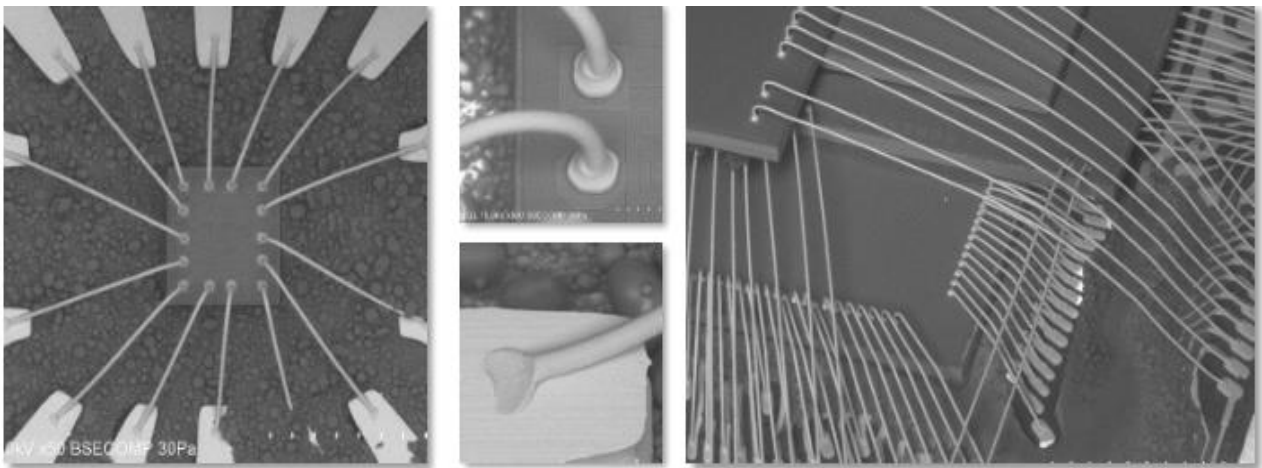
概要

半导体部品的低成本化加速了Au线向Cu线的转换。问题是使用现有的封装开封技术，Cu线将与树脂一起被溶解而受到损伤，会对后期的调查产生影响。故需要寻求一种可以结合IC形状等防止Cu线损伤的方法。

特征

结合线表面的观察、连接状况的确认、放射观察的通电等目的，实施封装开封。

树脂去除后线的状态



※由于开封后Cu线的状态因树脂类型、线种类、形状等程度各异，故建议提前试做。

Cu线问题调查事例

